

东南大学先进微纳加工中心（南京）和微纳系统国际创新中心（无锡）招聘岗位说明书

2024.07.19

编号	岗位名称	岗位职责	招聘要求	备注
A01	厂务主管 (南京)	1、熟悉工厂暖通空调系统、洁净室及设备构架及运行原理，包括但不限于冷水机组，冷却塔、MAU、AHU、FFU、DDC等； 2、制订暖通空调系统、洁净室设备的日常运行操作、维护保养工作流程，作业指导书和各种计划； 3、制订并起草暖通空调系统、洁净室相关的培训手册，并对技术人员进行培训； 4、针对现有的暖通空调系统、洁净室的运行的有效性，提出专业改进意见和建议，实施有效的节能措施； 5、配合中心主任优化洁净室运营，提升运营效率； 6、有清晰的职业规划，善于学习，成长型思维，愿意学习并承担除暖通空调外其它厂务系统的运行与维护(如给排水，空压，特殊气体，水处理，电力，自控等)。	1、本科及以上学历学位，半导体、电子信息、物理、材料及相关专业； 2、在电子信息、集成电路、半导体等相关行业微纳加工平台从事厂务综合管理相关工作3年以上。	1、工作地点在南京； 2、具备岗位适配的综合管理能力和专业技术水平。
A02	厂务主管 (无锡)	1、带领厂务工程师负责洁净间暖通系统、电力系统、纯水系统、特气系统、废水处理系统等的日常运行、维护保养、功能保障等工作； 2、带领设备工程师保障工艺设备运行、维修、培训等工作； 3、配合中心主任优化洁净间运营，提升运营效率，实现降本增效； 4、配合中心主任开拓产业技术服务； 5、保障洁净间工艺运行安全，对工程师进行指导和监督； 6、根据需求协助中心主任开展各类工程师招聘工作。	1、本科及以上学历学位，半导体、电子信息大类及相关专业； 2、在Fab厂或类似工艺平台从事厂务综合管理相关工作3年以上。	1、工作地点在无锡； 2、具备岗位适配的综合管理能力和专业技术水平。
B01	光刻工程师	1、负责掩膜光刻机、无掩膜光刻机、电子束光刻机的管理、培训、厂家对接和故障处理； 2、负责日常维护及工艺优化，维持设备工艺稳定，对设备异常进行故障分析和排除； 3、支撑光刻工艺服务，协助工艺开发； 4、协助学生培训、实训工作； 5、负责光刻工艺环节的安全管理，与其他工艺环节协同配合。	1、硕士及以上学历学位，微电子、材料、物理、化学、半导体、电气自动化、机电一体化等理工科相关专业； 2、熟知光刻工艺流程； 3、具有光刻机、电子束光刻EBL、Stepper使用/维护经验者优先。	1、工作地点在南京或无锡； 2、其中微纳系统国际创新中心（无锡）岗位要求具有Stepper使用/维护经验者优先。
B02	薄膜沉积工艺工程师	1、负责薄膜工艺区相关设备的管理和运行保障，负责设备培训和操作安全管理； 2、日常维护和安全检查，保障设备稳定，优化设备工艺条件； 3、对设备异常进行故障分析，负责和厂家对接及设备故障维修； 4、配合用户开发工艺，做好服务； 5、跟踪新设备装机调试，支撑新工艺导入； 6、负责薄膜工艺环节的安全管理，与其他工艺环节协同配合。	1、硕士及以上学历学位，微电子、材料、物理、化学、半导体、电气自动化、机电一体化等理工科相关专业； 2、熟知薄膜工艺流程相关知识； 3、有PVD、CVD、PECVD、ALD等使用/维护经验者优先。	工作地点在南京或无锡。
B03	刻蚀工艺工程师	1、负责刻蚀工艺区相关设备的管理和运行保障，负责设备培训和操作安全管理； 2、日常维护和安全检查，保障设备稳定，优化设备工艺条件； 3、对设备异常进行故障分析，负责和厂家对接及设备故障维修； 4、配合用户开发工艺，做好服务； 5、跟踪新设备装机调试，支撑新工艺导入； 6、负责刻蚀工艺环节的安全管理，与其他工艺环节协同配合。	1、硕士及以上学历学位，微电子、材料、物理、化学、半导体、电气自动化、机电一体化等理工科相关专业； 2、熟知刻蚀工艺流程相关知识； 3、有IRE、DRIE、NLD、IBF等刻蚀设备的使用/维护经验者优先。	工作地点在南京或无锡。
B04	光学和电子表征工程师	1、负责表征区相关设备的管理和运行保障，负责设备培训和操作安全管理； 2、日常维护和安全检查，保障设备稳定，优化设备工艺条件； 3、对设备异常进行故障分析，负责和厂家对接及设备故障维修； 4、配合用户开发工艺，做好服务； 5、跟踪新设备装机调试，支撑新工艺导入； 6、制备样品表征环节的安全管理，与其他工艺环节协同配合。	1、硕士及以上学历学位，微电子、材料、物理、化学、半导体、电气自动化、机电一体化等理工科相关专业； 2、熟知薄膜的厚度、形貌等光学和电子显微相关知识； 3、有椭偏仪、激光共聚焦显微镜、扫描电子显微镜等使用/维护经验者优先。	工作地点在南京。

东南大学先进微纳加工中心（南京）和微纳系统国际创新中心（无锡）招聘岗位说明书

2024.07.19

编号	岗位名称	岗位职责	招聘要求	备注
B05	扩散工艺工程师	<ol style="list-style-type: none"> 负责扩散工艺区相关设备的管理和运行保障，负责设备培训和操作安全管理； 日常维护和安全检查，保障工艺稳定，优化设备工艺条件； 对设备异常进行故障分析，负责和厂家对接及扩散设备的故障维修； 配合用户开发工艺，做好服务； 跟踪新设备装机调试，支撑新工艺导入； 负责扩散工艺环节的安全管理，与其他工艺环节协同配合。 	<ol style="list-style-type: none"> 硕士及以上学历学位，微电子、材料、物理、化学、半导体、电气自动化、机电一体化等理工科相关专业； 熟知扩散工艺流程相关知识； 有离子注入机、氧化扩散炉、退火炉、激活炉管理/使用经验者优先。 	工作地点在无锡。
B06	湿法工艺工程师	<ol style="list-style-type: none"> 负责湿法工艺区相关设备的管理和运行保障，负责设备培训和操作安全管理； 日常维护和安全检查，保障设备稳定，优化设备工艺条件； 对设备异常进行故障分析，负责和厂家对接及设备故障维修； 配合用户开发工艺，做好服务； 跟踪新设备装机调试，支撑新工艺导入； 负责湿法工艺环节的安全管理，与其他工艺环节协同配合。 	<ol style="list-style-type: none"> 硕士及以上学历学位，微电子、材料、物理、化学、半导体、电气自动化、机电一体化等理工科相关专业； 熟知湿法工艺流程相关知识； 有CMP、RCA清洗机、SPM清洗机等使用/维护经验者优先。 	工作地点在无锡。
B07	封装工艺工程师	<ol style="list-style-type: none"> 负责键合设备、磨抛设备、切割设备的管理和运行保障，负责设备培训和操作安全管理； 日常维护和安全检查，保障设备稳定，优化设备工艺条件； 对设备异常进行故障分析，负责和厂家对接及设备故障维修； 配合用户开发工艺，做好服务； 跟踪新设备装机调试，支撑新工艺导入； 负责键合工艺环节的安全管理，与其他工艺环节协同配合。 	<ol style="list-style-type: none"> 硕士及以上学历学位，微电子、材料、物理、化学、半导体、电气自动化、机电一体化等理工科相关专业； 熟知先进封装工艺流程相关知识； 有晶圆键合、倒装焊、减薄、CMP、划片等设备使用经验或管理经验者优先。 	工作地点在无锡。
B08	量测工程师	<ol style="list-style-type: none"> 负责SPM、Raman、XPS、SIMS等量测设备的管理和运行保障，负责设备培训和操作安全管理； 日常维护和安全检查，保障设备稳定，优化设备工艺条件； 对设备异常进行故障分析，负责和厂家对接及设备故障维修； 配合用户需求做好测试服务； 跟踪新设备装机调试，支撑测试方法创新发展； 负责测试区域的安全管理，与其他工艺环节协同配合。 	<ol style="list-style-type: none"> 硕士及以上学历学位，微电子、材料、物理、化学、半导体、等理工科相关专业； 熟知物性测试相关知识； 有SEM、椭偏仪、台阶仪、SPM、XPS、XRD、Raman、SIMS使用经验或管理经验者优先。 	工作地点在无锡。
B09	TEM工程师	<ol style="list-style-type: none"> 负责透射电子显微镜的操作使用、故障诊断与日常维护； 负责设备的使用培训、预约管理等相关工作； 承担或协助平台安排的电镜样品制备和测试分析等工作； 负责透射电镜的应用和设备相关技术开发； 承担TEM测试区其他设备的管理工作； 协助中心承担其他协同测试。 	<ol style="list-style-type: none"> 硕士及以上学历学位，物理、材料、化学、半导体、微电子等相关专业； 具有3年以上球差透射电镜和场发射透射电镜相关工作经验，熟悉透射电镜的操作与原理； 具有透射电镜样品的制备经验，或具有透射电镜操作和维护经验者优先； 具备良好的团队合作精神和协作能力，具有较强的创新精神能力。 	工作地点在无锡。
B10	FIB工程师	<ol style="list-style-type: none"> 负责聚焦离子束FIB、PFIB等设备的操作使用、故障诊断与日常维护； 负责设备的使用培训、预约管理等相关工作； 承担或协助平台安排的样品制备和测试分析工作； 负责FIB技术应用和设备相关功能开发； 承担FIB区其他设备的管理维护工作； 协助中心承担其他协同加工测试。 	<ol style="list-style-type: none"> 硕士及以上学历学位，物理、材料、化学、半导体、微电子等相关专业； 具有2年以上FIB或者双束电镜相关工作经验，熟悉FIB的操作与原理； 具有FIB使用/维护经验者优先。 	工作地点在无锡。